

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2878)

盈利警告

本公告乃由晶門半導體有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱作「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據本集團截至2023年6月30日止六個月之未經審核綜合管理賬目初步審閱以及董事會目前可得資料，本集團預期截至2023年6月30日止六個月將錄得未經審核股東應佔綜合溢利約12.0百萬美元至13.0百萬美元，較截至2022年6月30日止六個月約21.8百萬美元減少約40%至45%。未經審核股東應佔綜合溢利於2023年上半年減少之主要原因為(i)銷售收入減少，其主要由於本集團產品平均售價下跌；及(ii)毛利及毛利率減少，其主要由於本集團之產品之平均售價下跌與部分產品成本之下降不成比例。

儘管與2022年上半年相比，2023年上半年之未經審核股東應佔綜合溢利有所減少，惟董事會謹此強調，本集團於2023年上半年之未經審核股東應佔綜合溢利仍高於2022年下半年所錄得者，主要是由於產品開發策略更貼合市場需要，並因而使滯銷存貨之撥備減少，而本集團將繼續其現行之嚴格且有效的成本控制措施以提高營運效率。

本公司仍在擬定本集團截至2023年6月30日止六個月之中期業績。本公告所載列之資料僅為基於董事會對本集團截至2023年6月30日止六個月之最新及尚未經本公司獨立外聘核數師審閱或審核，亦未經董事會審核委員會審閱之未經審核綜合管理賬目所作之初步評估。本集團截至2023年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績可能需作進一步調整，並可能與本公告所載資料有所不同。本集團財務資料之進一步詳情預期將於2023年8月底前公佈之本公司截至2023年6月30日止六個月之中期業績公告中公佈。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
晶門半導體有限公司
行政總裁
王華志

香港，2023年7月21日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。